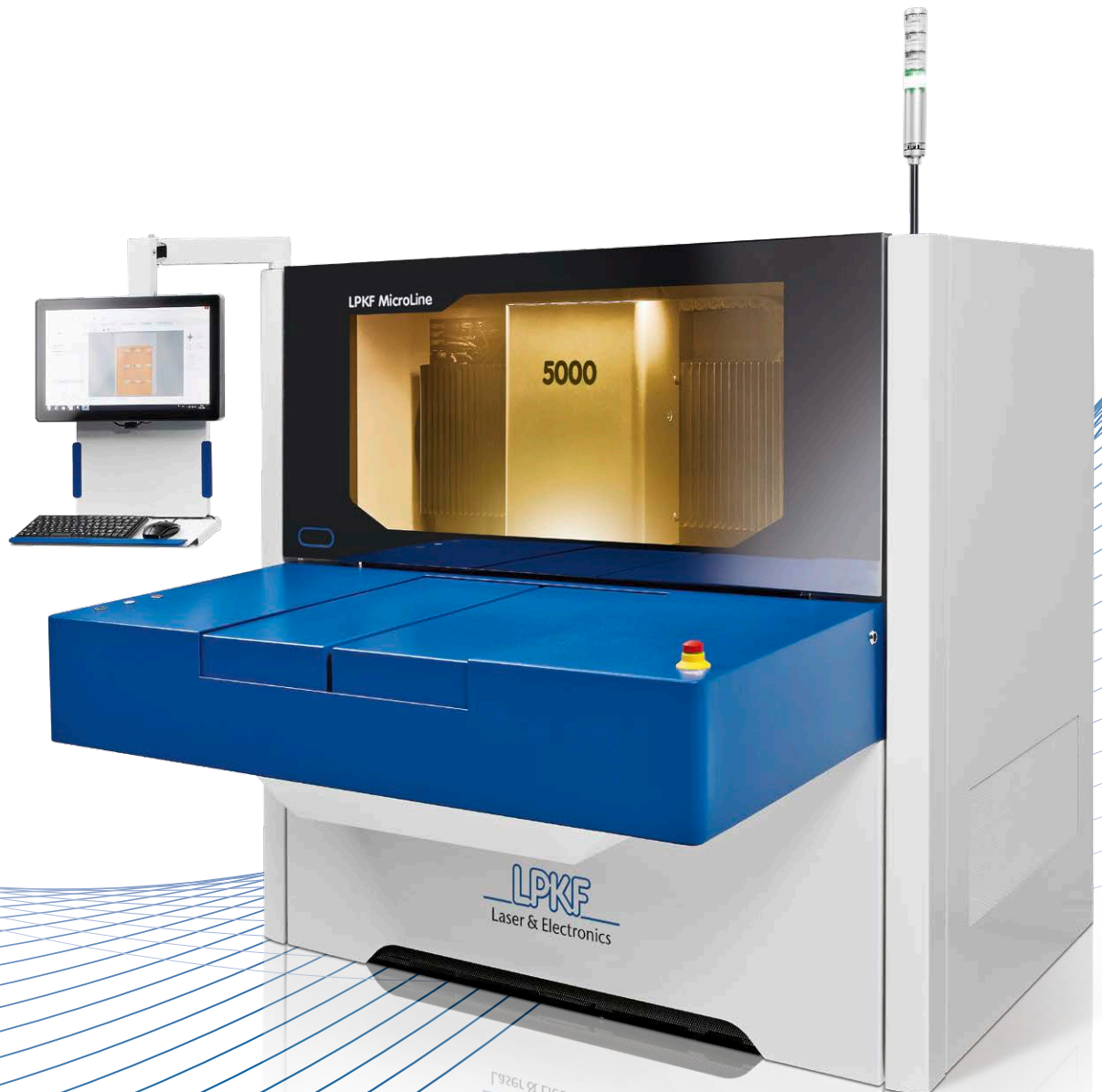


FPC 高速穴あけ加工・外形カット装置
LPKF MicroLine 5000 シリーズ



LPKF
Laser & Electronics

ЛРКФ
Лазер & Электроника

LPKF
Laser & Electronics

UVレーザーによるFPC穴あけ・外形カット装置

LPKFは低コスト、高品質、高精密の要求が高まるFPC製造工程において必要不可欠な、高速穴あけ・外形カット向けUVレーザー装置MicroLine 5000を開発しました。

卓越した穴あけパフォーマンス

MicroLine 5000はハイスループット、高い歩留まりを実現したFPC製造における最高の選択肢です。穴あけ最小加工サイズは20 µmで、FPC、IC基板、高密度実装基板等の有機材料、無機材料のワークを加工可能です。

最も最適化された使用用途はスルーホール加工やブラインドビア加工ですが比較的大きな穴あけ加工や輪郭カットも可能です。

高品質と高精度

最小限の熱影響によりデリケートな材料のカット加工と穴あけ加工を高品質のUVレーザーが実現します。このことは、きれいなカット断面を高精度かつほぼデブリゼロにて実現できる結果より証明されます。MicroLine 5000は用途に合わせ、レーザーソースを10 Wもしくは15 Wより選択できます。またさまざまなワークに対応できるよう搬送機構の接続も可能です。

輪郭カット

MicroLine 5000は多目的ツールです。多くの産業において使用されているパネルの最大サイズ533 x 610 mmを加工可能です。そして20 µm幅の高品質UVレーザーはデリケートな輪郭カットをハイスピードで実現します。

プロセスモニタリング

MicroLine 5000はハイスピード、高精度を確実にするビジョンシステム(原点マーク認識システム)を搭載しています。カメラは、ほぼすべての基板やジョブ毎に異なる原点マークを認識できるように機能します。

更に、搭載されているレーザーパワーメータにより信頼性や再現性のコントロールが確実に became。

技術データ: LPKF MicroLine 5000

レーザークラス	1
最大加工エリア (X x Y x Z)	533 mm x 610 mm x 11 mm
最大シートサイズ; 最大リール幅	533 mm x 610 mm; 500 mm
位置決め精度	±20 µm
レーザースポット直径	20 µm
レーザー波長	355 nm
装置寸法 (W x H x D)	1660 mm x 1720 mm x 1900 mm; ステータスライト含む = 2200 mm
装置重量	~2000 kg
動作環境	
電源	400 VAC, 3-phase, 50-60 Hz, 16 A, 7 kVA
冷却	空冷 (内蔵冷却サイクル)
湿度	22° C ± 2° C; <60% (結露無きこと)
必須アクセサリ	専用集塵機

MicroLine 5000シリーズは各々特長を持つMicroLine 5120 (10 Wレーザーソース)とMicroLine 5820 (15 Wレーザーソース)で構成されます。